

委托说明

根据项目任务要求，针对边缘物联网场景下传统芯片有效算力低、有效能效低、长时平均功耗高等关键问题，本项目拟开发超低功耗异步事件驱动型智能物联网芯片，旨在实现高效的算力比和超低能耗的电路设计。为达到这一指标，选择 TSMC 22nm CMOS RF ULL 工艺下进行多项目晶圆（MPW）流片，且该 CMOS 工艺的成本、速度能够满足项目任务书中异步事件驱动型芯片所需的相应指标。在进行了深入的调研并与多家公司进行咨询后，TSMC 22 nm CMOS RF Ultra Low Leakage ELK Cu 1P10M 0.8/2.5V 工艺在价格和性能上都表现出色。然而，能够提供这项技术服务并确保在规定时间内完成的公司并不多见。为了确保流片工作的顺利进行，我们联系并评估了多家技术服务公司，包括上海纳诺芯微电子科技有限公司、合肥市微电子研究院有限公司和苏州苏韵微电子有限公司。经核查比较，合肥市微电子研究院有限公司符合本次技术服务需求，并且收费合理、缩短交期，故拟委托合肥市微电子研究院有限公司在台积电进行 22nm 的 MPW 流片。

项目负责人：

马宇飞

日期：

2025.6.6

